

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成21年1月22日(2009.1.22)

【公開番号】特開2006-257408(P2006-257408A)

【公開日】平成18年9月28日(2006.9.28)

【年通号数】公開・登録公報2006-038

【出願番号】特願2006-36875(P2006-36875)

【国際特許分類】

C 09 J 201/00 (2006.01)

C 09 J 11/04 (2006.01)

C 09 J 9/02 (2006.01)

C 09 J 201/08 (2006.01)

H 01 B 1/22 (2006.01)

H 05 K 3/32 (2006.01)

【F I】

C 09 J 201/00

C 09 J 11/04

C 09 J 9/02

C 09 J 201/08

H 01 B 1/22 D

H 05 K 3/32 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年11月28日(2008.11.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

Sn及びBi及び/又はInを基本組成とする金属フィラー成分並びに樹脂成分を含んでなる導電性接着剤であって、

金属フィラー成分が、10～70重量%のBi、10～90重量%のIn及び残部のSnを含んでなることを特長とする導電性接着剤。

【請求項2】

金属フィラー成分が、15～65重量%のBi、15～80重量%のIn及び残部のSnを含んでなることを特長とする請求項1記載の導電性接着剤。

【請求項3】

金属フィラー成分が、20～57重量%のBi、20～52重量%のIn及び残部のSnを含んでなることを特長とする請求項1記載の導電性接着剤。

【請求項4】

金属フィラー成分が、0.1～1.0重量%のCuを更に含んでなることを特長とする請求項1～3のいずれかに記載の導電性接着剤。

【請求項5】

金属フィラー成分が、0.1～5.0重量%のAgを更に含んでなることを特長とする請求項1～4のいずれかに記載の導電性接着剤。

【請求項6】

金属フィラー成分が、0.001～0.1重量%のNiを更に含んでなることを特長とする請求項

1～5のいずれかに記載の導電性接着剤。

【請求項7】

樹脂成分が、第1の成分として硬化性樹脂を含み、第2の成分としてカルボキシル基を有する還元性の樹脂を含むことを特長とする請求項1～6のいずれかに記載の導電性接着剤。

【請求項8】

第2の樹脂成分は、金属を含む有機化合物を含有することを特長とする請求項7記載の導電性接着剤。

【請求項9】

前記金属は、Na、Ag、Cu及びKの群から選ばれることを特長とする請求項8記載の導電性接着剤。

【請求項10】

樹脂成分は、還元性を有する樹脂を含むことを特長とする請求項1～6のいずれかに記載の導電性接着剤。

【請求項11】

請求項1～10のいずれかに記載の導電性接着剤を用いて部品が接着されていることを特長とする回路基板。